

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

財務業績

本集團於截至二零零五年三月三十一日止年度之財務業績概要如下：

- 營業額約為522,000,000港元(二零零四年：443,000,000港元)，上升約18%。
- 除稅前溢利約為34,000,000港元(二零零四年：40,000,000港元)。
- 股東應佔日常業務純利約為32,000,000港元(二零零四年：40,000,000港元)。
- 每股基本盈利約為8.99港仙(二零零四年：12.13港仙)。

流動資金及資本結構

於二零零五年三月三十一日，本集團之流動資產323,000,000港元(二零零四年：298,000,000港元)主要包括預付款項、按金及其他應收款項約12,000,000港元(二零零四年：31,000,000港元)、存貨約85,000,000港元(二零零四年：80,000,000港元)、應收貿易賬款約153,000,000港元(二零零四年：117,000,000港元)及銀行現金71,000,000港元(二零零四年：68,000,000港元)。本集團之流動負債約為187,000,000港元(二零零四年：205,000,000港元)。流動比率由二零零四年三月三十一日約1.5上升至二零零五年三月三十一日之1.7。

於二零零五年三月三十一日，本集團共有總資產約504,000,000港元(二零零四年：478,000,000港元)及總負債約191,000,000港元(二零零四年：213,000,000港元)。負債比率(根據負債與股本之百分比計算)為12%(二零零四年：18%)。

財政資源

於二零零五年三月三十一日，本集團之浮息銀行借貸約為35,000,000港元(二零零四年：41,000,000港元)，其中33,000,000港元(二零零四年：38,000,000港元)以人民幣定值，並主要用於本集團在國內之營運支出及流動資金。本集團之銀行借貸全部須於一年內償還。於二零零五年三月三十一日，本集團之銀行借貸以下列各項作為抵押：(i)本集團若干位於香港之租賃土地及樓宇與投資物業之第一法定抵押；(ii)本集團之汽車之第一法定抵押；及(iii)本公司提供之公司擔保。

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

財政資源(續)

由於本集團大部份銷售及採購均以港元及人民幣定值，而鑑於港元及人民幣匯率維持穩定，董事認為本集團毋須承受重大外匯波動風險。年內，本集團並無使用任何金融票據作為對沖用途，而本集團於二零零五年三月三十一日並無任何對沖票據尚未償還。

於二零零五年三月三十一日，現金及銀行結存約為69,000,000港元(二零零四年：約66,000,000港元)，當中約20,000,000港元(二零零四年：約24,000,000港元)以人民幣定值，而餘額大部份以港元定值。

或然負債

截至結算日，本公司就銀行給予本集團之一般信貸額作出擔保，該銀行信貸額約為219,000,000港元(二零零四年：161,000,000港元)，本集團截至結算日已動用其中約92,000,000港元(二零零四年：59,000,000港元)。

年內本公司一間附屬公司之一名客戶於中國增城地方法院對該附屬公司提出民事申訴(「訴訟」)。在訴訟中，該名客戶指稱該附屬公司違反了一份工程合約(「該合約」)之若干條件，包括延遲生產線組裝工程。

根據本公司中國法律顧問之意見，董事認為該附屬公司具有理據，該訴訟之索償不大可能成功，因此，董事認為該訴訟不會帶來重大法律責任。

資本承擔

截至二零零五年三月三十一日，本集團於注資中國附屬公司及共同控制企業方面分別約有10,000,000港元(二零零四年：13,000,000港元)及零港元(二零零四年：5,000,000港元)之資本承擔。

資本承擔將由內部融資支付。

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

僱員及薪酬政策

於二零零五年三月三十一日，本集團聘用約1,700名全職僱員，其中約1,650人駐於中國，而約50人則駐於香港辦事處。

本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現今勞工法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供醫療計劃、退休金計劃及與表現掛鉤花紅等員工福利。

業務回顧

回顧過去一年，本集團整體業務發展理想，營業額有長足的增長。本年度之營業額為522,000,000港元，比去年增長百分之十八，創本集團歷史性新高。錄得如此強勁的升幅，一則有賴於整體市場已走出二零零三年沙士疫症的陰霾，經濟逐漸復蘇，本集團之營業額亦隨著市場規模擴大而增加；二則是受惠於歐洲聯盟(「歐盟」)明年執行的新環保指令，全面禁止使用鉛化焊接設備，無鉛化的趨勢為本集團生產的無鉛電子組裝設備帶來高速增長。

本集團於回顧年度之毛利約為100,000,000港元，與上年度相若，毛利率則下調兩個百分點至百分之十九。毛利未有跟隨營業額上升，主要由於原林料如鋼材、鋁及零部件等價格於年度內大幅上漲，加上市場競爭越趨激烈，產品價格難以提升，使本集團之邊際利潤受壓。

在市場分佈方面，於二零零四／零五年財政年度，本集團的銷售額中有百分之七十九及百分之十七乃分別來自中國及香港市場；其餘為來自出口至歐盟等地的銷售收入。

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

各項業務表現分析

本集團主要替電子業生產商提供生產設備，屬於製造業的上游廠商。業務可分四大類：電子組裝設備、自動化生產線方案、半導體封裝設備及鈹金業務。

1. 電子組裝設備

電子組裝設備為本集團的主營業務，主要是製造及買賣焊錫設備、代理貼片機、生產及銷售絲印機，以及相關的設計及配套服務。二零零四／零五年度這業務的銷售額約佔本集團營業額七成。

a. 焊錫設備

本集團主要從事設計、製造及買賣焊錫設備。去年銷售增加主要是歐盟訂定新的環保指令，規定於二零零六年七月一日後入口歐盟地區的電子設備不能含鉛。為符合歐盟的新修訂，現行普遍使用含鉛焊錫設備的電子廠商，需於明年七月一日前更換或添置無鉛焊錫設備；與此同時，中國電子組裝設備需求亦伴隨整體經濟的發展步伐繼續增長。

本集團與德國著名的焊錫設備生產商Rehm-Anlagenbau GmbH組成共同控制企業，主力生產高精密度的回流焊設備，該公司在深圳的工廠已於二零零四年七月全面投產，大大提高本集團在高檔焊錫設備市場的佔有率及地位，並提升本集團的研發能力。高精密度回流焊設備技術含量高，其毛利率較本集團的傳統產品為高。

b. 貼片機

近年中國市場對貼片機的需求迅速增長。本集團主要代理海外著名品牌的貼片機，更是韓國的三星泰科(Samsung Techwin)貼片機在中國大陸及香港的獨家代理商，連續八年成為三星泰科全球各地代理商中營業額最高的代理商。本集團代理的三星泰科貼片機是中國的中檔貼片機市場其中一種最暢銷品牌。為擴大客戶的層面，本集團亦有銷售西門子等高速貼片機，開拓不同檔次的貼片機市場。

各項業務表現分析(續)

1. 電子組裝設備(續)

c. 絲印機

本集團為擴大絲印機的業務規模，近年不斷加強在絲印機業務的研發及生產能力。二零零三年十月，本集團自行研製的視覺全自動印刷機(編號：SEM-668)取得了香港工業獎，充份引證本集團在絲印機的研發能力已達國際先進水平。SEM-668絲印機已於去年全面投產及買賣，帶動本集團這項業務迅速發展。

2. 自動化生產線方案

為替客戶提供全面配套的服務，本集團除了供應生產設備外，亦為客戶設計及組裝整條生產線，提供全面的自動化生產線方案。這項業務有助提升本集團自行生產及代理產品的銷售。

3. 半導體封裝設備

半導體封裝業務雖為本集團近年新開發的業務，銷售增長迅速，主要由於本集團的半導體封裝技術趨於成熟，令產品銷量上升。

半導體封裝業務分為Chip On Board(「COB」)及Chip On Glass(「COG」)兩大類，COB機型較外國進口品牌的性能相若同類機型有較強的價格競爭優勢。本集團與日本廠商合作研製COG焊線機；目前國內市場的COG焊線機市場仍以日本及韓國機為主，但憑藉成本低廉的優勢，本集團將在市場上佔一席位。

4. 鍍金業務

本集團的鍍金業務已發展成熟，為本集團提供可觀現金收入。本集團的鍍金部門除供應本身生產所需外，亦為多個國際知名客戶生產中、高檔產品的金屬零部件。

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

展望

基於中國電子信息產品製造業將保持較快增長以及中國EMS產業正逐漸發展和壯大，加上電子產品已邁向便攜式和小型化的發展方向及無鉛化生產要求將促進現有設備升級換代，未來五年中國SMT設備市場將會進入高速增長的時代。

據賽迪顧問報告顯示，二零零五年至二零零九年中國SMT設備市場的年均增長率將達到16%，到二零零九年中國SMT設備市場規模將達到人民幣465.4億元，佔全球市場份額42.8%。本集團作為香港及大陸地區最大的焊錫設備生產商，將是焊錫市場迅猛增長的直接得益者。

隨著各國對環保日益重視，無鉛化已成為全球電子設備的發展方向，本集團作為無鉛電子組裝設備的生產商將有龐大的商機。本集團早於數年前已洞悉電子設備無鉛化的大趨勢，開始研製無鉛化設備。無鉛焊錫設備由二零零二年佔本集團焊錫設備的總銷售額不足百分之五，至今已佔焊錫設備總銷售額達百分之五十。預期二零零五年中國焊錫設備市場的增長率為65%，二零零六年為29%。本集團在無鉛化的部署，在未來數年將會為集團帶來可觀的增長空間。

面對愈來愈多著名外資焊錫設備生產商將生產基地搬進國內，本集團不斷推出新式的無鉛化焊錫設備。為了維持集團產品的技術優勢，並透過嚴格的成本控制來創造價格優勢，本集團繼與哈爾濱工業大學有研發合作外，將繼續與其他專上學府進行科研合作，研發新產品。

與此同時，本集團將致力透過與德國著名的焊錫設備生產商Rehm-Anlagenbau組成合資企業提升日東產品技術水平，打破以往以中、低檔設備為主的局面。我們期望日東以後在高、中、低檔市場佔有主導地位。

管理層討論與分析

日東科技(控股)有限公司 • 二零零五年年報

展望(續)

而貼片機業務方面，賽迪顧問估計，中國貼片機市場規模未來一年將有四成多的增長，而需求仍以中低速產品為主。因應市場發展的態勢，本集團仍會以代理三星泰科的貼片機為主，務求在擴展中的中檔市場佔有主導地位。除現時已開拓的珠江三角洲地區，本集團並會大力發展長江三角洲及環渤海地區這兩個於未來數年增長最快的市場，以期於三至五年內，本集團代理的貼片機業務佔有國產市場重要份額。

另外，賽迪顧問估計在二零零五年中國絲印機市場將有超過六成的增長，二零零六年亦會有大約三成的增長。為擴充絲刷機市場，本集團積極研發技術先進的高性能機型，並與著名學府展開合作研究計劃，以具成本效益的方法加快研發速度。本集團正爭取於明年初推出新一代的機型。

展望來年，中國的製造業將會持續增長，自動化生產線設備市場因而亦會平穩增長。日東的策略將會以規模較大的工程為目標市場，並積極爭取汽車行業的訂單，提高邊際利潤。

半導體封裝業務方面，我們預期，憑藉日東在全國現有的銷售網絡及其他業務的客戶群，可有效擴闊這項業務的銷售，COB業務在未來一年將會有可觀的增長；並藉著成本低廉的優勢，成為COG焊線機市場上其中一個主要供應商。

本集團已擬定發展策略，抓緊市場急速增長的機遇，擴大不同產品的市場佔有率。